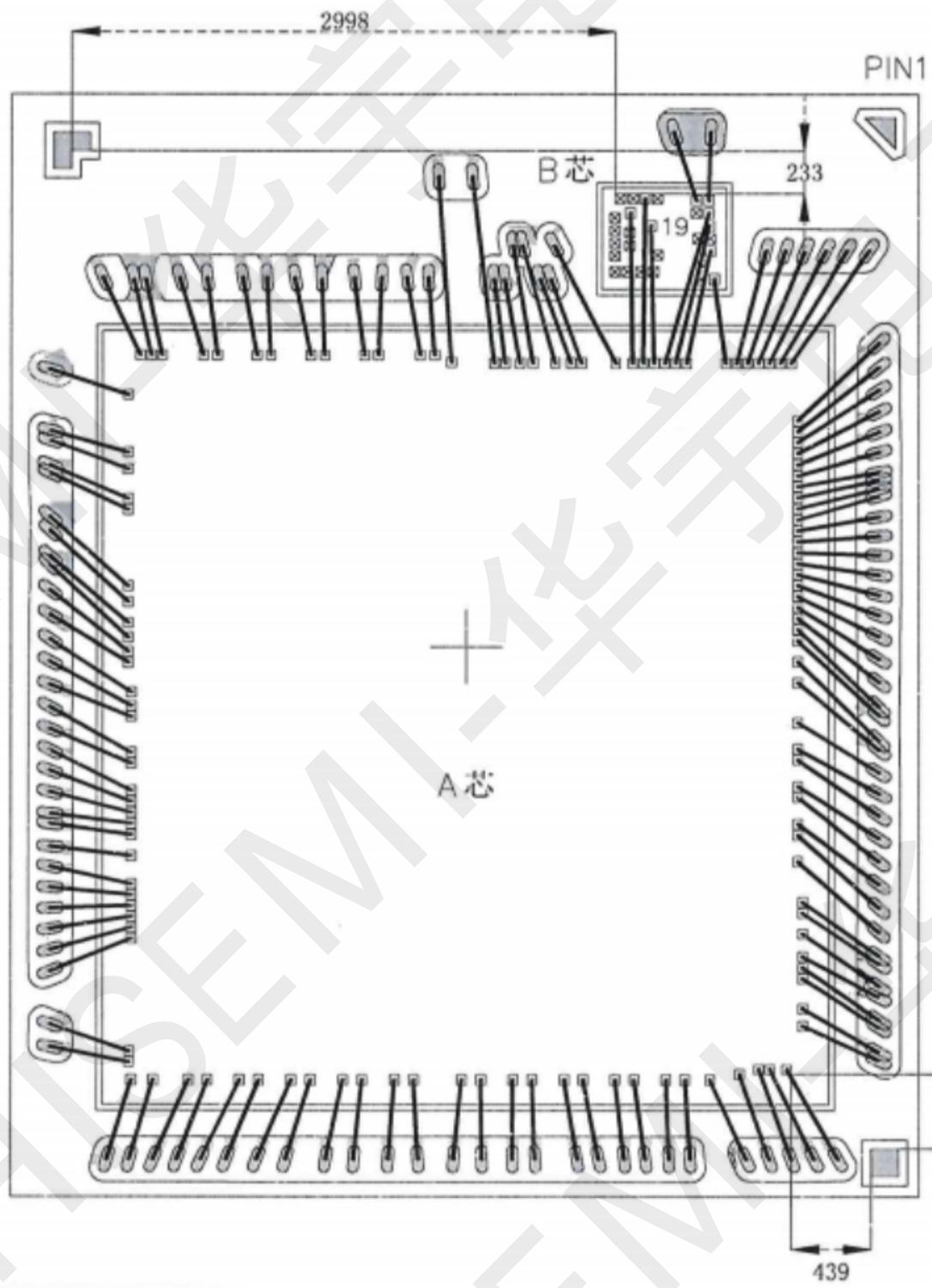
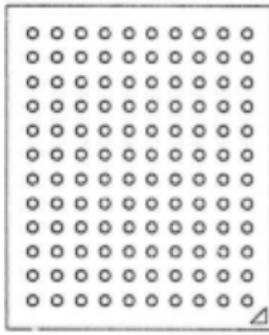


站别 DB&WB



封装类型	WB-BGA
塑封厚度	300um
锡球型号/ 尺寸/间距	SAC305 /200um/450um
基板切割道	250um
基板厚度	210um
表面处理	TOP & BOTTOM: NiAu



底部示意图 PIN1